

Бланк заказа печатных плат

Сведения о заказчике

Название фирмы-заказчика	Филиал ОАО "НПК"СПП" в Великом Новгороде
Контактное лицо	Чурилов Г.И.
Телефон, факс	(8162)224937
Дата заполнения заказа	20.07.12
Размер платы X*Y, мм	200*272
Толщина платы	2.3
Количество плат	16

Общие сведения о плате

Количество слоев	16
Тип материала (FR4, СЕМ1, ХРС, другой)	Rogers Ro4350, полиимид
Минимальный проводник	0.1
Минимальный зазор	0,1
Минимальное металлизированное отверстие	0.2
Маскирующее покрытие (да/нет)	да
Цвет маски	Синий
Маркировка (да/нет, кол-во сторон)	нет
Цвет маркировки	
Покрытие контактных площадок (ПОС-61, иммерсионное золото, никель)	Иммерсионное золото
Переходные отверстия открыты от маски?	нет
Золочение на разъеме(да/нет)	нет
Внутренние вырезы (да/нет)	нет
Фаска на разъеме (да/нет)	нет
Электроконтроль (да/нет)	да
Заполнение переходных отверстий смолой с последующим покрытием медью	да
Толщина фольги, мкм (по умолчанию 18мкм)	35,18мкм

Сведения о файле заказа

Название файла (файлов)	ССPUP
Формат файла	GERBER
Единицы измерения (дюймы, псевдодюймы, мм -- только для РСAD)	мм

Перечень технологических слоев

(названия слоев в САD системе или имена файлов)

Контур и вырезы	ССPUP_BRD.GBR			
Топология стороны компонентов (прямая)	ССPUP_TOP.GBR			
Топология стороны пайки (зеркальная)	ССPUP_BOT.GBR			
Маскирующее покрытие стороны компонентов	ССPUP_TMK.GBR			
Маскирующее покрытие стороны пайки	ССPUP_BMK.GBR			
Токопроводящее покрытие (Carbon Ink) стороны компонентов				
Токопроводящее покрытие (Carbon Ink) стороны пайки				
Сверловка (металлизированные отверстия)	ССPUP_Plated_1.DRL ССPUP_Plated_2.DRL			

Сверловка (неметаллизированные отверстия)	CCPUP_NonPlated.DRL		
Внутренний слой 1	CCPUP_GND1.GBR		
Внутренний слой 2	CCPUP_S1.GBR		
Внутренний слой 3	CCPUP_S2.GBR		
Внутренний слой 4	CCPUP_GND2.GBR		

Внутренний слой 5	CCPUP_S3.GBR		
Внутренний слой 6	CCPUP_S4.GBR		
Внутренний слой 7	CCPUP_GND3.GBR		
Внутренний слой 8	CCPUP_POWER.GBR		
Внутренний слой 9	CCPUP_S5.GBR		
Внутренний слой 10	CCPUP_S6.GBR		
Внутренний слой 11	CCPUP_GND4.GBR		
Внутренний слой 12	CCPUP_S7.GBR		
Внутренний слой 13	CCPUP_S8.GBR		
Внутренний слой 14	CCPUP_POWER1.GBR		

Плата гибко-жесткая. Толщина платы 2.3мм, толщина шлейфа 0.45мм.
Предполагаемая структура платы прилагается. Волновое сопротивление дифференциальных пар в слоях TOP, S1, S2, S4, S6 100 Ом. Волновое сопротивление проводников в слоях S1...S8 50 Ом.
Панелизация ГЖПП (панель для автоматического монтажа элементов на плату).